

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	时代伯乐、信达澳亚、固禾资产、芊榕基金、鑫然投资、康曼德投资、第一创业、兴全基金、昱阳基金、华富基金、东证锦信、国金证券、财通基金、浙商证券、东海证券、申万菱信、中哲物产、摩根基金、湘财证券、华源证券、歌汝基金、东吴证券、富国基金、华商基金、惠升基金、国海证券、银华基金
会议时间	2026年5月11日-2026年5月15日
会议地点	利阳芯（东莞）微电子有限公司会议室 上海利扬创芯片测试有限公司会议室 上海浦东丽思卡尔顿酒店 上海东方滨江酒店 上海文华东方酒店 上海金茂君悦大酒店
上市公司接待人姓名	董事、总经理：张亦锋
投资者关系活动主要内容介绍	<ul style="list-style-type: none"> ● 行业概况和公司近况简要介绍 ● 提问环节 <p>（一）在 AI 芯片测试领域的布局与技术储备？目前 AI 芯片业务订单能见度如何？未来 AI 业务营收增长有怎样预期，是否有配套</p>

产能扩产规划？

在技术储备层面，公司目前正大力布局持续加大 AI（如 CPU、GPU、NPU、ASIC 等）技术研发投入与专业测试能力储备；截至 2025 年末，公司在研项目涉及 AI 相关的有：“手机及终端 AI 影像芯片全链路测试平台研发项目”“第一代 AI 算力芯片测试平台研发”“HBM 存储芯片集成化测试系统与软件协同开发”等。

在客户层面，公司持续与国内 CPU、GPU 等 AI 头部客户保持常态化紧密对接，跟进客户需求变化，提前统筹推进产能储备与布局，全力配合客户新产品及量产落地进程。具体产品量产时间节点，将结合技术研发进展、项目验证节奏、客户实际需求及国内先进制程晶圆制造产能释放等综合因素统筹审慎确定。

集成电路测试的订单具有下单频繁、服务周期短等特点，因此在手订单数量通常仅能反映公司短期内的销售订单情况。同时，部分对公司产能有需求的客户，通常会未来 1-3 月的测试计划发送至公司，便于安排生产。

当前国内先进制程产能仍存在阶段性约束，行业整体处于发展爬坡阶段。但随着国内先进晶圆厂工艺水平、量产良率稳步提升，加之先进封装产能持续布局落地，芯片测试产能或将成为产业链下一环节的关键瓶颈。

同时，国内 AI 芯片相关企业陆续登陆资本市场，获得资本赋能加持，行业发展动能持续增强。基于上述产业趋势，公司对 AI 芯片测试赛道的长期成长空间保持高度乐观，国内 AI 芯片测试需求的中长期确定性与可持续性显著提升。

产能布局层面，公司将计划通过自有资金、银行贷款、资本市场再融资等多元化渠道，持续加码投入 AI 芯片专项测试产能建设。公司判断，在产业链整体进展顺利、市场需求按计划落地的前提下，未来 1-2 年将是国内 AI 算力芯片产业发展的关键转折期；若行业发展态势符合预期，公司各类融资及资金筹措工作顺利落地且产能按期建成投产，预计 2026 年下半年起 AI 业务将逐步实现营收贡献，2027 年以及未来有望成长为公司核心业绩增长极之一。

（二）介绍一下公司左翼激光隐切部分业务情况？激光隐切可适用哪些范围芯片？

公司左翼围绕晶圆减薄、激光开槽、隐切等技术服务，这是芯片从晶圆测试到封装的必备环节，是公司主营业务向下的延伸，

可以充分满足客户日益增长的对芯片产品高品质和低成本的综合诉求。

2025 年，公司晶圆磨切业务营业收入 1,537.37 万元，同比增长 81.04%；自成立以来，依托长期深耕积累的优质客户资源与成熟营销团队，公司稳步释放业务协同价值，有序推进激光隐切业务的探索培育与市场拓展，截至 2025 年累计导入客户近 90 家，为后续营收增长与盈利能力提升奠定坚实基础。

（三）有关注到公司近期涨价的消息，主要涨价的原因和未来是否继续涨价的趋势？

公司部分测试产能需求较为紧张，为保证稳定可靠的产品交付能力，为客户提供持续优质服务，从 4 月 1 日开始对小部分测试服务价格调涨 10%-15%，本次价格上调对公司整体营业收入占比偏低，本次价格调整预计对公司整体经营及业绩影响较为有限；公司未来是否涨价将根据市场供需关系决定。

（四）近期关注到公司有加入中关村商业航天产业联盟，请问是基于什么考虑的？

公司基于前沿技术前瞻布局，正式加入中关村商业航天产业联盟，为积极探索前沿科技应用领域迈出关键一步。目前相关业务尚处于前期研究布局阶段，项目落地及业务规模化推进存在不确定性，短期内对公司经营业绩及营业收入暂无实质贡献。

（五）公司在汽车电子领域是否有对应的测试方案和客户情况如何？可介绍这类客户的类型和主营业务？

公司早在 2018 年获得与汽车电子相关的认证，目前已经覆盖 MCU、多媒体主控芯片、传感器、电源管理、通信、存储等主流汽车电子产品类，具备完善配套测试技术储备，可充分满足各类汽车电子芯片的测试需求。汽车电子相较于传统芯片测试要求更为严苛，除常温测试外，还需完成高低温极限环境测试，全面匹配车载场景高可靠的应用诉求。客户层面，主要服务国内头部新能源车企下属企业和汽车电子设计公司等核心客户群体；目前汽车电子业务对公司营收贡献呈逐年快速增长态势，已成为公司重要的业务增长部分。

（六）公司目前与叠铖光电合作的进展情况？

2025 年 5 月，公司与叠铖光电共同完成“光谱芯片”全部工艺并成功点亮。2025 年 7 月，与公司联合打造的“光谱芯片”芯

片上车（矿场卡车）成功演示。2025 年 11 月，公司与广东车卫士信息科技有限公司、叠铖光电签订战略合作协议，推动全球首个矿区全天候无人驾驶商业化项目在广东大亚湾砂石 1 号矿落地，标志着单车智能无人驾驶将从实验室迈入商业化运营。

（七）公司 2026 年一季度保持增长且扭亏为盈的原因？

公司一季度营业收入同比增长 27.87%，主要在消费电子、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等相关芯片的测试收入同比大幅增长；随着公司营业收入规模扩大，固定成本得以有效摊薄，经营杠杆效应凸显，实现扭亏为盈。